

연구프로젝트 신청서 [캡스톤디자인, SFEP연계 팀현장실습]

신청인	박 나 영	모바일	010-6312-1366
부서/직위		E-Mail	nypark_94@naver.com
기업명	(주)에이아이엠	홈페이지	http://www.aimkor.com/
대표이사	나용주	모바일	010-4111-6911
		E-Mail	
산업체 멘토 (CTO/ 연구소장)		모바일	
		E-Mail	
신청인은 이 프로젝트를 위의 기업과 협의하여 신청하였습니다. ☑			
프로젝트명	◆프로젝트명 : 웨이퍼 실시간 두께 변화 모니터링 및 평판도 측정 시스템 개발		
프로젝트 내용	<p>◆필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> 최근 첨단 전자 기기가 널리 사용됨에 따라 경량화 추세에 맞추어 칩이나 패키지를 적층하는 삼차원 집적화 기술 개발이 핵심기술로 중요시 되고 있다. 따라서 칩의 소형화와 더불어 경량화를 요구하고 있으며, 반도체 집적도를 높이기 위해 웨이퍼 위 소자의 크기와 간격을 줄이기 위한 노력이 이루어지고 있다. 웨이퍼의 결함 또는 손실을 제때 식별하는 것은 중요한 사항이다. 웨이퍼 매핑 시스템은 실시간으로 웨이퍼를 측정하고, 시각화하여 웨이퍼의 특성을 한눈에 파악할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. <p>◆(연구) 프로젝트 내용 및 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> CCD를 이용한 시스템변수 보정 머신 비전 모델 개발을 통한 웨이퍼 두께 실시간 모니터링 멀티포커싱 AI신경망을 이용한 시각화 연구 결과를 기반으로 논문을 작성하고 해외 학술지에 제출 . <p>◆(연구) 프로젝트 성과 활용 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> 성과 활용 : 개발된 모니터링 시스템은 웨이퍼 측정을 실시간으로 감지하여 최적화된 시각을 할 수 있게 할 수 있다. 이 시스템은 시각의 예지 또한 가능하게 할 수 있음으로써 불량률 최소화 할 수 있다. 기대효과 : 이 연구는 반도체 산업의 발전에 기여에 기대된다. 또한 불량률을 줄이는데 기여 할 수 있다. 		
기타			
희망 참여학과 및 최소요건	<ul style="list-style-type: none"> SW 개발 및 AI에 관심이 있는 학생 반도체 관련 관심이 있는 학생 		
요청 사항	<ul style="list-style-type: none"> 비대면 모임 위주로 진행하며, 필요 시 대면 모임 예정 		